~N&K光學薄膜測厚儀~ 基本操作手冊

湯淵富 2019.1.1

大綱

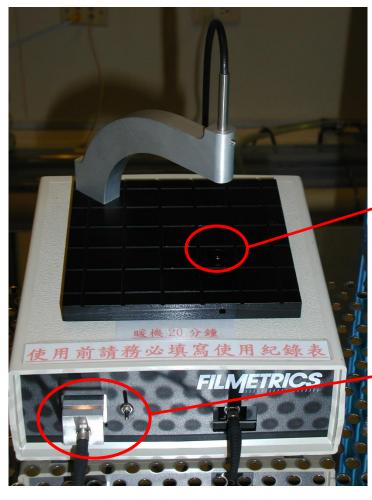
- 一、N&K光學薄膜測厚儀使用規範
- 二、N&K光學薄膜測厚儀的實際操作

一、 N&K 光學薄膜測厚儀使用規範

- 01. 欲操作N&K光學薄膜測厚儀之研究生或同仁均須通過考核。
- 02. 欲考核下列南科NDL機台(1)破片光阻塗佈機(2)自動化光族塗佈與顯影系統(Track) (3)高溫及低壓水平爐管(4)PECVD,需一併接受n&k薄膜測厚儀之考核。
- 03. 使用N&K光學薄膜測厚儀須確實填寫使用紀錄簿。
- 04. 厚度量測有其極限,大約為 $200 ext{\AA} \sim 50 ext{um}$ 。
- 05. 無法量測金屬,因無法透光。
- 06. 無法直接量測Poly-Silicon薄膜,需先成長一層氧化層(約1000Å)於矽晶圓上,再沉積多晶矽薄膜於氧化層上,方可量得多晶矽薄膜之厚度。
- 07. 光源使用前需先暖機20分鐘以上,確定不再使用後再將光源關閉。(避免經常性開開關關)
- 08. 合格使用人員若將機台使用卡外借他人使用,取消使用資格三個月。

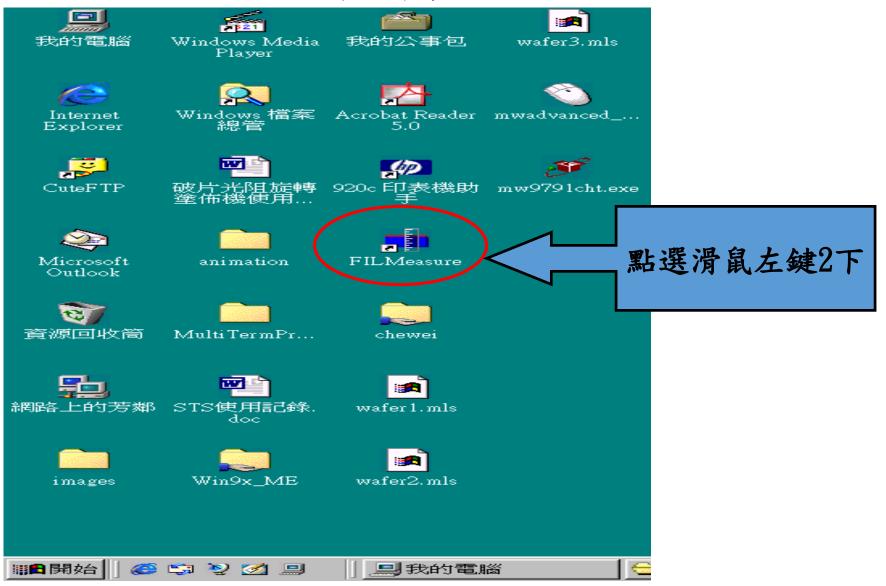
二、N&K光學薄膜測厚儀的實際操作

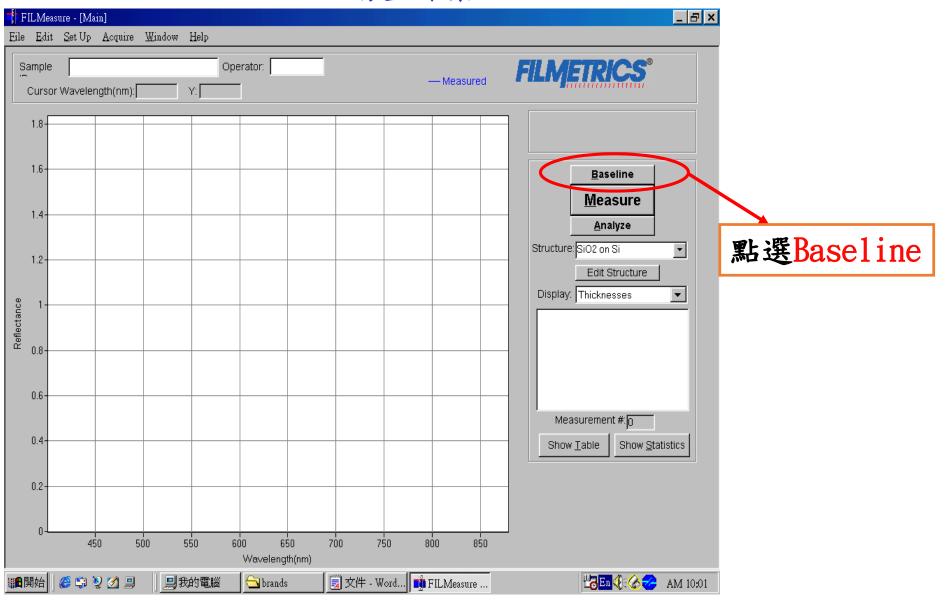


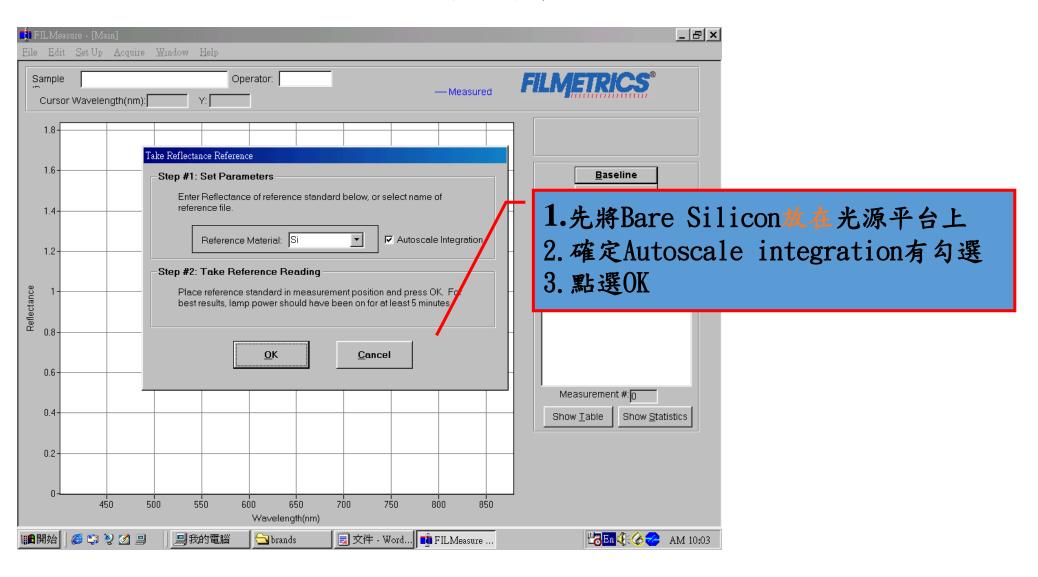


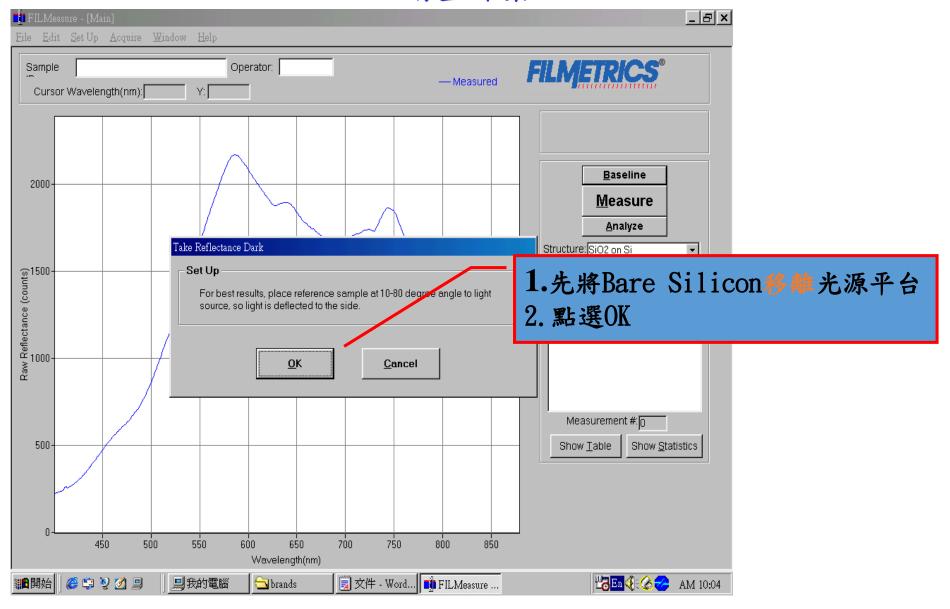
- a. 待量測試片位置
- b. 量測區域需大於 光源1x1cm以上
- c. 欲量測之晶圓正面朝上

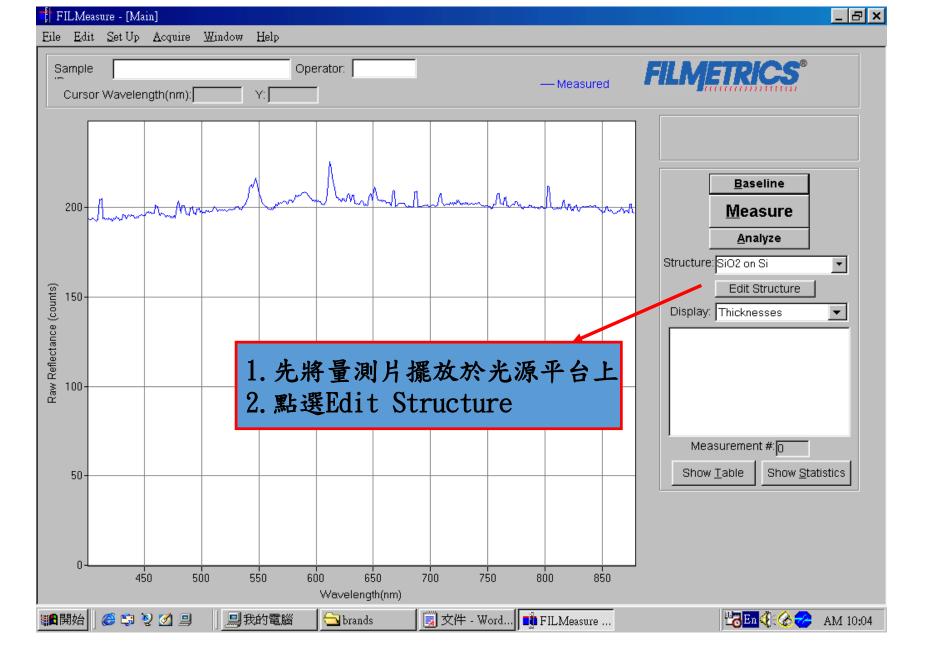
打開燈源確定燈源亮起並暖機20分鐘以上



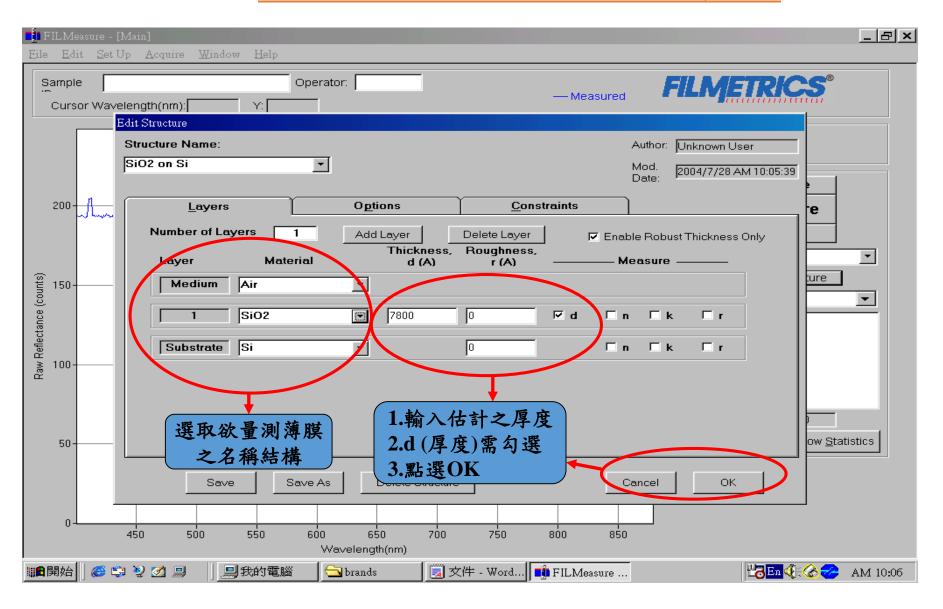


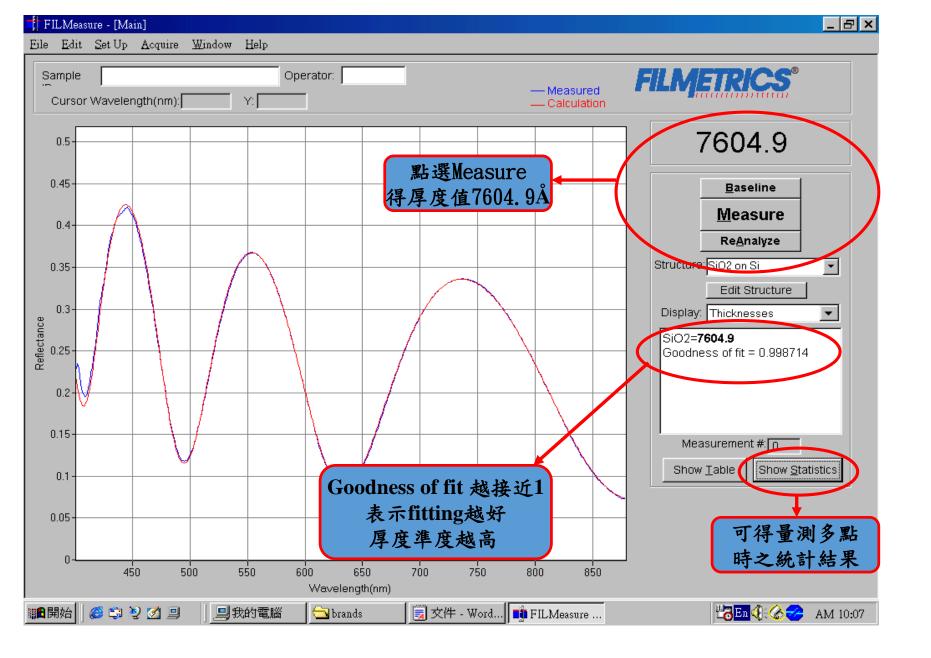


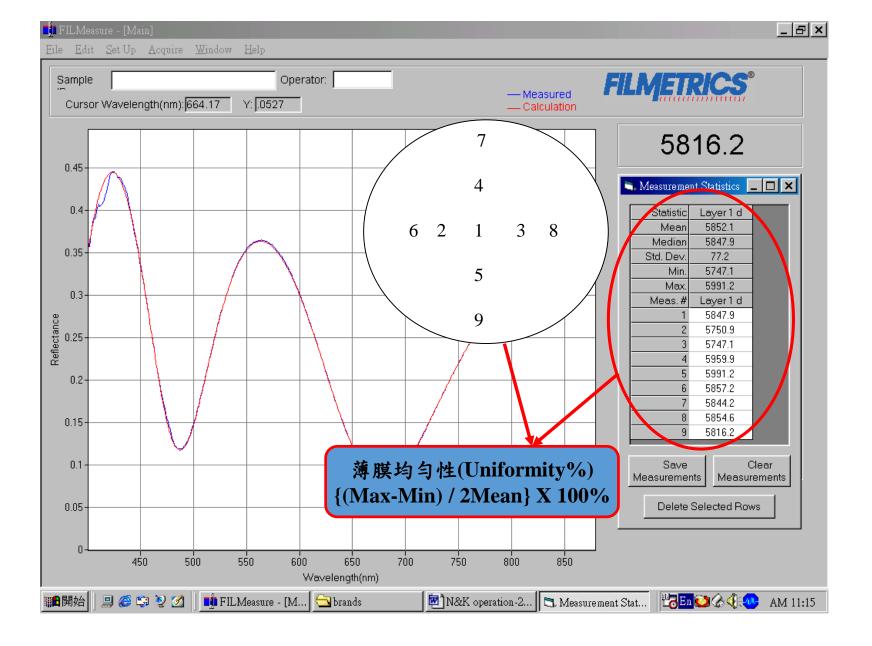




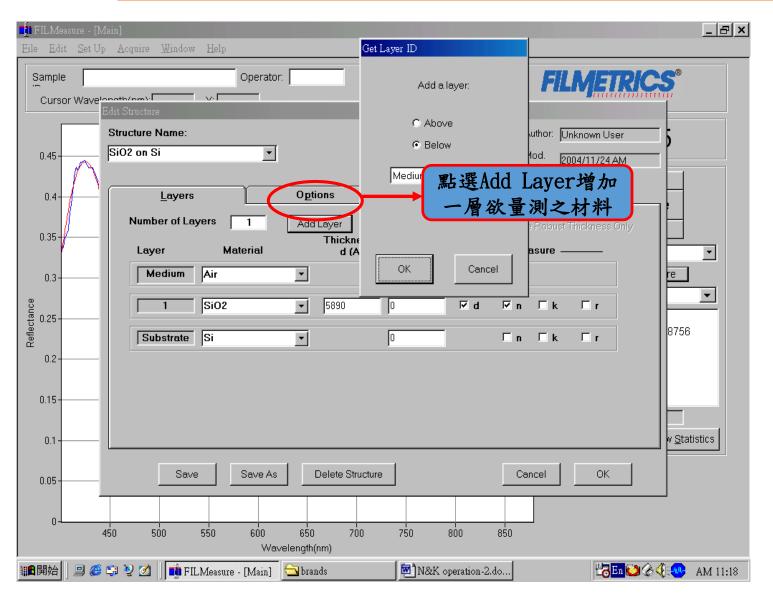
Casel:Silicon/Si02薄膜(單層)

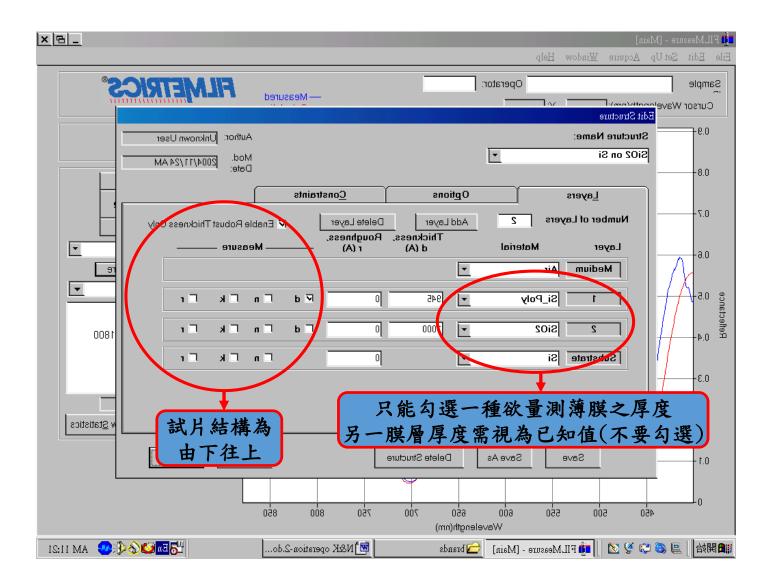


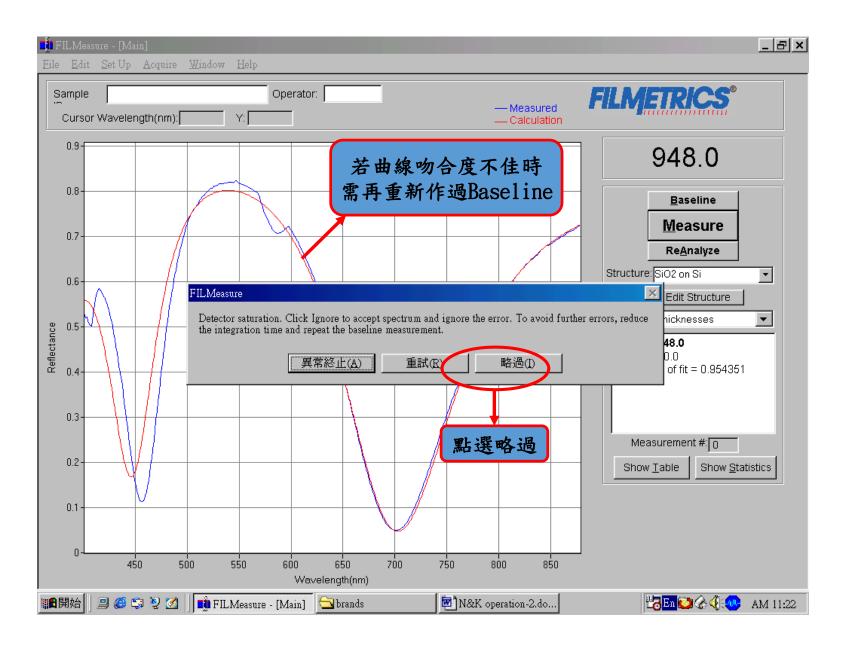




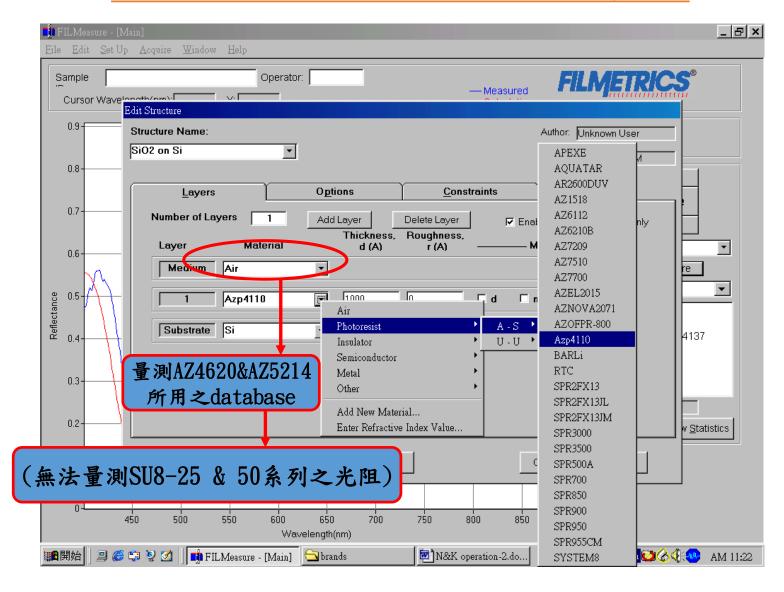
Case2:Silicon/Si02/Poly Si薄膜(雙層)







Case3:Silicon/Photoresist(單層)



當量測曲線吻合度不佳時

